

2013年5月20日

報道関係各位

## ダッソー・システムズ、建設・建築業界向けに 新インダストリー・ソリューション・エクスペリエンス(ISE) 「リーン・コンストラクション」を発表

### 3Dを活用したプロジェクト管理ソリューションによって リアルタイムに進捗を管理、無駄を削減し利益を向上

3D エクスペリエンス企業であり、3D 設計ソフトウェア、3D デジタル・モックアップ、そしてプロダクト・ライフサイクル・マネジメント(PLM)ソリューションにおける世界的リーダーであるダッソー・システムズ (Euronext Paris: #13065, DSY.PA)は本日、協調的なプロジェクト管理と実施の効果的な運用を促進する建設・建築業界向けインダストリー・ソリューション・エクスペリエンス(ISE)、「リーン・コンストラクション」を発表しました。

建設・建築業界においては、関係者間の連携が十分にとれていない場合、往々にして計画や設計と実際のプロジェクトの間に大きな隔たりが生じ、それがコスト超過や竣工時期の遅れ、収益の減少に直結することがあります。ダッソー・システムズの 3D エクスペリエンス・プラットフォームに基づいて開発された「リーン・コンストラクション」ISE は、建設・建築業界のあらゆる企業が、完全なガバナンスを確立しながら、どこからでも、複雑な各種プロジェクトを運用・管理・体系化できる、プロジェクト・コラボレーションのためのバックボーンを提供します。本ソリューション・エクスペリエンスは、統合 3D 環境により、オフィスと現場のチーム間コミュニケーションを促進します。また本ソリューション・エクスペリエンスでは、プロジェクト・ステータスがリアルタイムで可視化され、関係者間で共有できます。これによってプロジェクトに関わるすべての関係者が最新の状況を確認しつつ必要な変更を迅速に行えるため、プロジェクト全体のコスト管理が向上し、不要な事柄や無駄を排除し、プロジェクトの利益率を改善します。

企業は「リーン・コンストラクション」ISE の活用によって、建設手法や組み付け順序の中から様々な選択肢を検討および分析し、最適な建設アプローチを構築できます。その後、人や設備といったリソースを割り当て、計画の費用対効果や収益性を把握し、実際の業務を開始する前に調整・変更が可能です。プロジェクトの開始後は、事前の合意不足や未解決の問題等の存在、プロジェクト全体のコスト増と収益減につながる恐れがある急な予定変更等によって想定外の事態に直面しないよう、「リーン・コンストラクション」を使ってリアルタイムで進捗を管理・追跡することができます。

ダッソー・システムズのインダストリーおよびマーケティング担当、エグゼクティブ・バイス・プレジデントであるモニカ・メンギニ(Monica Menghini)は次のように述べています。「世界の建設業界は長年にわたり、遅延やコスト超過、非効率性に悩まされてきました。推定では、建設業界のコストの約 25%、また米国単独でも年間 1,200 億ドルの無駄が生じていると言われていました。このような状況において、当社の『リーン・コンストラクション』インダストリー・ソリューション・エクスペリエンスは、建築・建設企業

がプロジェクト全体をよりよく把握し、BIM(建築情報モデリング)テクノロジーの効果によって発展するのを支援します。」

ダッソー・システムズの建築・建設業界向けインダストリー・ソリューション・エクスペリエンスの詳細情報についてはこちらをご覧ください: <http://www.3ds.com/solutions/architecture-engineering-construction>

(以上)

#### **ダッソー・システムズについて**

ダッソー・システムズは、3D エクスペリエンス企業として、企業や個人にバーチャル・ユニバースを提供することで、持続可能なイノベーションを提唱します。世界をリードする同社のソリューション群は製品設計、生産、保守に変革をもたらしています。ダッソー・システムズのコラボレーティブ・ソリューションはソーシャル・イノベーションを促進し、現実世界をよりよいものとするため、バーチャル世界の可能性を押し広げます。ダッソー・システムズ・グループは 140 カ国以上、あらゆる規模、業種の 15 万社以上のお客様に価値を提供しています。より詳細な情報は、[www.3ds.com](http://www.3ds.com) (英語)、[www.3ds.com/jp](http://www.3ds.com/jp) (日本語)をご参照ください。

CATIA、SOLIDWORKS、SIMULIA、DELMIA、ENOVIA、GEOVIA、EXALEAD、NETVIBES、3DSWYM および 3D VIA はアメリカ合衆国、またはその他の国における、ダッソー・システムズまたはその子会社の登録商標です。